

中国芯片产业市场发展分析及前景展望与投资研究报告(2024-2029版)

报告简介

芯片是一种微型电子器件，又称集成电路。目前除部分国际巨头外，芯片行业已形成设计业、加工制造业、封装测试业三业分离、共同发展的局面。芯片是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过80%的销售额，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。

麦肯锡预测到2030年，汽车和工业部门将分别占芯片销售额平均增长的14%和12%，从而推动这十年的需求增长，这说明了这些行业对芯片的需求不断增长。

尽管当前全球半导体市场出现短期低迷，但长期来看芯片需求有望呈现强劲增长态势。国家先后出台的《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》等政策均提到，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关，着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。目前，中国集成电路行业已在全球集成电路产业中占据重要市场地位。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息技术有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、中国海关总署、国务院发展研究中心、世界半导体贸易统计协会、中国半导体行业协会、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国芯片及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国芯片行业发展状况和特点，以及中国芯片行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的芯片行业发展态势作了详细分析，并对芯片行业进行了趋向研判，是芯片经营、开发企业，服务、投资机构等单位准确了解目前芯片业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一章 芯片行业的总体概述

第一节 基本概念

第二节 制作过程

一、原料晶圆

二、晶圆涂膜

三、光刻显影

四、掺杂杂质

五、晶圆测试

六、芯片封装

七、测试包装

第二章 2019-2023年全球芯片产业发展分析

第十二节 2019-2023年世界芯片市场综述

一、市场特点分析

二、全球发展形势

三、全球市场规模

四、市场竞争格局

第二节 美国

一、全球市场布局

二、行业并购热潮

三、行业从业人数

四、类脑芯片发展

第三节 日本

一、产业订单规模

二、技术研发进展

三、芯片工厂布局

四、日本产业模式

五、产业战略转型

第四节 韩国

一、产业发展阶段

二、技术发展历程

三、外贸市场规模

四、产业创新模式

五、市场发展战略

第五节 印度

- 一、芯片设计发展形势
- 二、政府扶持产业发展
- 三、产业发展对策分析
- 四、未来发展机遇分析

第六节 其他国家芯片产业发展分析

- 一、英国
- 二、德国
- 三、瑞士

第三章 中国芯片产业发展环境分析

第一节 政策环境

- 一、智能制造政策
- 二、集成电路政策
- 三、半导体产业规划
- 四、“互联网+”政策

第二节 经济环境

- 一、国民经济运行状况
- 二、工业经济增长情况
- 三、固定资产投资情况
- 四、经济转型升级形势
- 五、宏观经济发展趋势

第三节 社会环境

- 一、互联网加速发展

二、智能产品的普及

三、科技人才队伍壮大

第四节 技术环境

一、技术研发进展

二、无线芯片技术

三、技术发展趋势

第四章 2019-2023年中国芯片产业发展分析

第一节 中国芯片行业发展综述

一、产业发展历程

二、全球发展地位

三、海外投资标的

第二十二节 2019-2023年中国芯片市场格局分析

一、市场规模现状

二、市场竞争格局

三、行业利润流向

四、市场发展动态

第三节 2019-2023年中国量子芯片发展进程

一、产品发展历程

二、市场发展形势

三、产品研发动态

四、未来发展前景

第四节 2019-2023年芯片产业区域发展动态

一、湖南

二、贵州

三、北京

四、晋江

第五节 中国芯片产业发展问题分析

一、产业发展困境

二、开发速度放缓

三、市场垄断困境

第六节 中国芯片产业应对策略分析

一、企业发展战略

二、突破垄断策略

三、加强技术研发

第五章 2019-2023年中国芯片产业上游市场发展分析

第十二节 019-2023年中国半导体产业发展分析

一、行业发展意义

二、产业政策环境

三、市场规模现状

四、产业资金投资

五、市场前景分析

六、未来发展方向

第二十二节 019-2023年中国芯片设计行业发展分析

一、产业发展历程

二、市场发展现状

三、市场竞争格局

四、企业专利情况

五、国内外差距分析

第三节 2019-2023年中国晶圆代工产业发展分析

- 一、 晶圆加工技术
- 二、 国外发展模式
- 三、 国内发展模式
- 四、 企业竞争现状
- 五、 市场布局分析
- 六、 产业面临挑战

第六章 芯片设计行业重点企业经营分析

第一节 高通公司

- 一、 企业发展概况
- 二、 经营效益分析
- 三、 新品研发进展
- 四、 产品应用情况
- 五、 未来发展前景

第二节 博通有限公司(原安华高科技)

- 一、 企业发展概况
- 二、 经营效益分析
- 三、 新品研发进展
- 四、 产品应用情况
- 五、 未来发展前景

第三节 英伟达

- 一、 企业发展概况
- 二、 经营效益分析
- 三、 新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第四节 amd

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第五节 marvell

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第六节 赛灵思

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第七节 altera

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第八节 cirrus logic

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第九节 联发科

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第十节 展讯

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、产品应用情况

五、未来发展前景

第十一节 其他企业

一、海思

二、瑞星

三、dialog

第七章 晶圆代工行业重点企业经营分析

第一节 格罗方德

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第二节 三星

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第三节 tower jazz

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第四节 富士通

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第五节 台积电

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第六节 联电

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第七节 力晶

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第八节 中芯

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第九节 华虹

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、企业发展形势
- 四、产品发展方向
- 五、未来发展前景

第八章 2019-2023年中国芯片产业中游市场发展分析

第十二节 019-2023年中国芯片封装行业发展分析

- 一、封装技术介绍
- 二、市场发展现状
- 三、国内竞争格局
- 四、技术发展趋势

第二十二节 019-2023年中国芯片测试行业发展分析

- 一、ic测试原理
- 二、测试准备规划
- 三、主要测试分类
- 四、发展面临的问题

第三节 中国芯片封测行业发展方向分析

- 一、承接产业链转移
- 二、集中度持续提升
- 三、国产化进程加快
- 四、产业短板补齐升级
- 五、加速淘汰落后产能

第九章 芯片封装测试行业重点企业经营分析

第一节 amkor

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第二节 日月光

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第三节 矽品

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第四节 南茂

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第五节 顾邦

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第六节 长电科技

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第七节 天水华天

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第八节 通富微电

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第九节 士兰微

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、未来前景展望

第十节 其他企业

- 一、 utac
- 二、 j-device

第十章 2019-2023年中国芯片产业下游应用市场发展分析

第一节 led

- 一、全球市场规模
- 二、led芯片厂商
- 三、主要企业布局
- 四、封装技术难点
- 五、led产业趋势

第二节 物联网

- 一、产业链的地位
- 二、市场发展现状
- 三、物联网wifi芯片
- 四、国产化的困境
- 五、产业发展困境

第三节 无人机

- 一、全球市场规模

二、市场竞争格局

三、主流主控芯片

四、芯片重点应用领域

五、市场前景分析

第四节 北斗系统

一、北斗芯片概述

二、产业发展形势

三、芯片生产现状

四、芯片研发进展

五、资本助力发展

六、产业发展前景

第五节 智能穿戴

第六节 智能手机

第七节 汽车电子

第八节 生物医药

第十一章 中国芯片行业投资分析

第一节 行业投资现状

一、全球产业并购

二、国内并购现状

三、重点投资领域

第二节 产业并购动态

一、arm

二、intel

三、nxp

四、 dialog

五、 avago

六、 长电科技

七、 紫光股份

八、 microsemi

九、 western digital

十、 on semiconductor

第三节 投资风险分析

一、 宏观经济风险

二、 环保相关风险

三、 产业结构性风险

第四节 融资策略分析

一、 项目包装融资

二、 高新技术融资

三、 bot项目融资

四、 ifc国际融资

五、 专项资金融资

第十二章 中国芯片产业未来前景展望

第一节 中国芯片市场发展机遇分析

一、 市场机遇分析

二、 国内市场前景

三、 产业发展趋势

第二节 中国芯片产业细分领域前景展望

一、 芯片材料

二、芯片设计

三、芯片制造

四、芯片封测

图表目录

图表：2019-2023年全球半导体市场销售规模

图表：2019-2023年全球芯片销售规模

图表：2023年全球ic公司市场占有率

图表：2023年欧洲ic设计公司销售规模

图表：2019-2023年美国半导体行业从业人员规模变动情况

图表：2019-2023年人类每秒每\$1000成本所得到的计算能力增长曲线

图表：28nm单个晶体管历史成本

图表：日本综合电机企业的半导体业务重组

图表：东芝公司半导体事业改革框架

图表：智能制造系统架构

图表：智能制造系统层级

图表：mes制造执行与反馈流程

图表：云平台体系架构

图表：2019-2023年国内生产总值及其增长速度

图表：2019-2023年末人口数及其构成

图表：2019-2023年城镇新增就业人数

图表：2019-2023年全员劳动生产率

图表：2023年居民消费价格月度涨跌幅度

图表：2023年居民消费价格比2019-2023年涨跌幅度

图表：2023年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况

图表：2019-2023年全国一般公共预算收入

图表：2019-2023年末国家外汇储备

图表：2019-2023年粮食产量

图表：2019-2023年社会消费品零售总额

图表：2019-2023年货物进出口总额

图表：2019-2023年货物进出口总额及其增长速度

图表：2023年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表：2023年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表：2023年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

图表：2023年外商直接投资(不含银行、证券、保险)及其增长速度

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20230614/444977.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)